



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

*2019年3月26日に発表されたプレスリリースの抄訳です

タワージャズ、パナソニックセミコンダクタソリューションズ社と

3年間の契約延長を発表

**パナソニックは TPSCo が保有する日本の 3 工場を引き続き利用；
タワージャズは最先端の技術ソリューションとファンドリ事業をさらに本格化**

イスラエル、ミグダル ハエメクおよび日本、魚津 2019年3月26日ー グローバルスペシャルティファンドリリーダーの[タワージャズ](#)とパナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社 (TPSCo) は本日、2022 年までパナソニックセミコンダクターソリューションズ社 (PSCS) とパートナーシップを延長する 3 年契約を締結したことを発表しました。この合意に基づき、PSCS は引き続き TPSCo の国内 3 工場を半導体事業に利用します。PSCS が TPSCo の工場でウェハを生産する規模は、新しい価格設定の元、同程度に維持される予定です。その結果、四半期ごとに約 2000 万ドルの収益減となる見込みですが収益と利益は、現行の効率化およびコスト削減活動、そして現在の強力な 300mm 工場の立ち上げ含む、サードパーティからの収益増で補償されることを目標としています。

タワージャズの CEO 兼 TPSCo 会長の Russell Ellwanger 氏は次のようにコメントしています。「TPSCo のパートナーシップは、アナログコンポーネントで有名でありシステムのリーダーでもあるパナソニックとアナログファンドリのリーダーとして認知されているタワージャズの 2 社が設立した会社で、既存のファンドリが達成できなかったアナログファンドリ分野での成長を続けています。過去 5 年間、当社はパナソニックのパートナーとしての技術力とビジネスに対する洞察力、そして積極的な取り組み姿勢で成長を続けてきました。TPSCo の従業員は豊富な技術の専門知識と遂行力で、現在 TPSCo のお客様として 180 社以上を獲得するまでになっており、300mm 工場の RF、パワーマネジメント、CMOS イメージセンサの力強い生産増加につながっています。これは、タワージャズ、PSCS、TPSCo、そして大切なお客様など、関係者全員にとって勝利の方程式となっているのです。」

TPSCo を通じて、タワージャズは、最先端の 65nm CMOS イメージセンサソリューション、65nm RF SOI および 65nm BCD パワーマネジメントプラットフォームなど、先進の 300mm アナログテクノロジーでの生産プラットフォームを提供しています。

タワージャズは引き続き TPSCo の 51%の株式を保有し PSCS が 49%を保有します。

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE:TSEM)は、その子会社とタワージャズというブランド名でグローバルに事業を展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、コンシューマー、産業機械、車載用、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で次世代の集積回路(IC)を生産しており、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS)を提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、日本に 3 か所(200mm と 300mm)の生産拠点を保有しています。詳細は www.towerjazz.com をご覧ください。

パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社について

パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社(TPSCo)は、タワーセミコンダクター社(NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)が 51%、パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社が 49%の株式を保有する合弁会社です。TPSCo は 35 年以上にわたり製造実績がある北陸地区の工場で 7.5 億個以上の車載用の(グレード 0,1,2)大規模集積回路を製造しています。主なプロセス技術は、高感度イメージセンサ(CIS および CCD)、パワーデバイス(BCD、SOI、LDMOS)、高周波 RFCMOS などです。 200mm および 300mm のウェハでサブミクロンから 45nm まで 150 を超えるプロセスフローと内製のバックエンドプロセス、アッセンブリ・テストサービスにより、TPSCo は、IDM とファブレス企業の双方にインハウスターンキーサービスを含め、これまでより優れた半導体製造の品質と技術を提供しています。

Company / Investor Relations Contact: Noit Levy | +972-4-604-7066 | noit.levi@towerjazz.com